

HiMod® FlatSeal™ 20

Résistance durable
aux hautes pressions



Your Partner for Sealing Technology

Une gamme de joints plats adaptée aux exigences du marché

La gamme de joints plats HiMod® est composée de produits qui satisferont aux exigences d'étanchéités pour les applications Aéronautiques, Chimiques, et des Industries de Process. Cette gamme répond aux plus grands standards tels que FDA et aussi ceux concernant les émissions fugitives et les tests d'éclatement sous pression.

HiMod® FlatSeal™ 20

Les joints en HMF20 ont une très bonne résistance à la pression sur le long terme. Ils ont également un très faible taux de fuites et répondent aux standards en termes d'émissions fugitives.

Applications

- Pétrochimie
- Chimie de process
- Construction et maintenance d'usine
- Applications industrielles en général

Caractéristiques et avantages

- Très haute résistance aux pressions sur le long terme
- Compatible avec la plupart des substances habituellement utilisées dans les industries chimiques telles que les huiles, les graisses, les acides, les dérivés alcalins, les solvants, les fluides réfrigérants, l'eau et la vapeur
- Bonne résistance à la température
- Sa durée de vie étendue réduit les intervalles entre deux maintenances
- Compense un grand nombre des irrégularités de surfaces et de géométries des brides
- Sans solvant, respectueux de l'environnement
- Taux de fuite inférieur aux limites de la norme DIN 3535-6
- Blowout Résistant
- Répond aux standards en termes d'émissions fugitives.
- Homologation DVGW, KTW, BAM*, VP-401, WRAS, W270, TA Luft

Bon pour l'homme et l'environnement

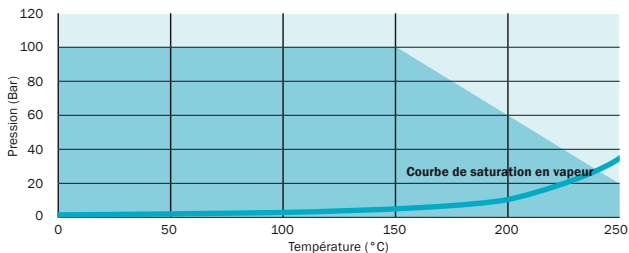
HiMod® FlatSeal™ 20 est fabriqué sur des sites de production répondants aux normes ISO/TS 16949 et ISO 14001. Ceci implique une maîtrise sans faille des processus de fabrication et un haut niveau de sécurité pour nos clients.

Caractéristiques Techniques du HiMod® FlatSeal™ 20

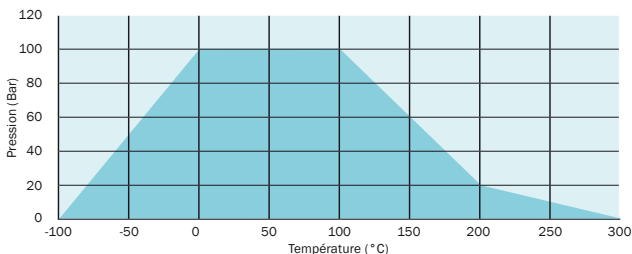
Recommandations d'utilisation

En fonction de la pression et de la température

Eau / Vapeur



Autres fluides*

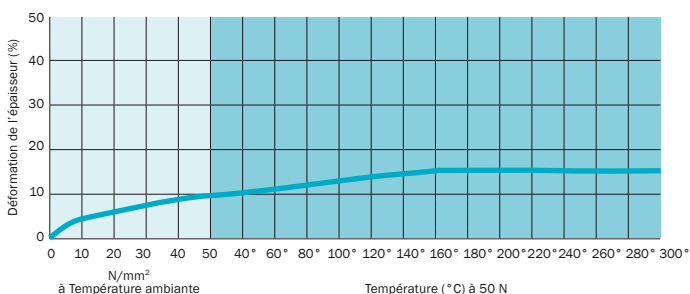


La température et la pression recommandées dans les graphiques correspondent à des joints d'épaisseur 2,0 mm installés dans une bride (état de surface fin).

* Des charges importantes sont possibles lorsque des joints plus minces sont utilisés.

Exemple pour la plupart des substances utilisées. Données exactes pour les cas spécifiques disponibles sur demande.

Comportement au fluage sous température 2,0 mm



Données techniques

Données générales	
Composition	Graphite, Fibre aramide, NBR
Agréments	DVGW, KTW, WRAS, W270, VP401, BAM* (max 110 °C / 130 Bars), TA Luft
Couleur	Bleu roi
Traitement anti adhérent	Sur les deux faces, conforme au standard A310
Epaisseur en mm	1,0/1,5/2,0/3,0 Autres dimensions sur demande
Tolérances d'épaisseur	Selon DIN 28091-1

Caractéristiques physiques épaisseur 2,0 mm	Standard	Unité	Valeur**
Désignation	DIN 28 091-2		FA - A 1 - 0
Masse volumique	DIN 28 090-2	[g/cm ³]	1,70
Résistance à la traction Sens longitudinal Sens transversal	DIN 52 910	[N/mm ²] [N/mm ²]	18 14
Résistance au fluage sous pression $\sigma_{AE/16}$ A 175 °C A 300 °C	DIN 52 913	[N/mm ²] [N/mm ²]	37 30
Compressibilité	ASTM F 36 J	[%]	7
Reprise élastique	ASTM F 36 J	[%]	60
Déformation à froid ϵ_{KSW}	DIN 28 090-2	[%]	6
Déformation rémanente à froid ϵ_{KRW}	DIN 28 090-2	[%]	3
Déformation à chaud $\epsilon_{WSW/200}$	DIN 28 090-2	[%]	6
Déformation rémanente à chaud $\epsilon_{WRW/200}$	DIN 28 090-2	[%]	2
Déformation rémanente R	DIN 28 090-2	[mm]	0,04
Taux de fuite spécifique	DIN 3535-6	[mg/(sm)]	≤ 0,1
Taux de fuite spécifique $\lambda_{2,0}$	DIN 28 090-2	[mg/(sm)]	≤ 0,1
Résistance chimique	ASTM F 146		
ASTM IRM 903 Variation de masse Augmentation d'épaisseur	5h/150 °C	[%] [%]	≤ 10 ≤ 5
ASTM Fuel B Variation de masse Augmentation d'épaisseur	5h/23 °C	[%] [%]	≤ 10 ≤ 5
Teneur en chlorure	FZT PV-001-133	[ppm]	≤ 50

* en cours d'homologations. ** Valeur moyenne (typique).

Pour plus d'informations sur la gamme HiMod® FlatSeal™, merci de contacter Trelleborg Sealing Solutions France

www.tss.trelleborg.com